PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-153700

(43)Date of publication of application: 16.06.1995

(51)Int.Cl.

H01L 21/205 H01L 21/365 H01L 33/00 H01S 3/18

(21)Application number : 05-321100

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

26.11.1993

(72)Inventor: TODA ATSUSHI

ASANO TAKEHARU

(54) ORGANOMETALLIC VAPOR GROWTH METHOD AND PREPARATION OF LIGHT-**EMITTING ELEMENT**

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an MOCVD method enabling formation of a compound semiconductor layer containing Mg and an MOCVD method enabling easy formation of a grated structure for

the compound semiconductor layer.

CONSTITUTION: An MOCVD method wherein a II-VI compound semiconductor layer is formed by using an organometallic compound of biscyclopentadienyl magnesium series of which a vapor pressure at 330° CK 15 1.3 × 10 Pa (0.1 torr) to 1.3 × 102Pa (1.0 torr), or an MOCVD method wherein a four-element mixed crystal series compound semiconductor layer constituted of two kinds of group II elements and two kinds of group VI elements is formed and wherein the flow rate of one of two kinds of material gases containing the group VI elements is changed in a state of the flow rates of two kinds of material gases containing the group II elements being held fixed and thereby the compositional rates of the group II elements in the compound semiconductor layer are changed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-153700

(43)公開日 平成7年(1995)6月16日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L	21/205				
	21/365				
	33/00	D			
H 0 1 S	3/18				
				審査請求	未請求 請求項の数16 FD (全 10 頁)
(21)出願番号		特顧平5-321100		(71)出願人	000002185
					ソニー株式会社
(22)出願日		平成5年(1993)11月	∄26日		東京都品川区北品川6丁目7番35号
				(72)発明者	戸田 淳
					東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
					一株式会社内
				(72)発明者	浅野 竹春
					東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内 (74)代理人 弁理士 山本 孝久

(54) 【発明の名称】 有機金属気相成長法及び発光素子作製方法

(57)【要約】

【目的】Mgを含む化合物半導体層を形成し得るMOC VD法、及び化合物半導体層にグレーティッド構造を容 易に形成することを可能にするMOCVD法を提供す る。

【構成】MOCVD法は、330°Kにおける蒸気圧が1.3×10Pa(0.1トル)乃至1.3×10²Pa(1.0トル)であるビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物を用いてII-VI族化合物半導体層を形成する。あるいは又、2種類のII族元素及び2種類のVI族元素から成る四元混晶系化合物半導体層を形成するMOCVD法であって、II族元素を含む2種類の原料ガスのガス流量を一定に保持した状態で、VI族元素を含む2種類の原料ガスの内の一方のガス流量を変化させることによって、化合物半導体層中のII族元素の組成割合を変化させる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】330° Kにおける蒸気圧が1.3×10 Pa乃至1.3×10²Paであるピスシクロペンタジ エニルマグネシウム系の有機金属化合物を用いてII-VI族化合物半導体層を形成することを特徴とする有機 金属気相成長法。

【請求項2】ピスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物は、ピスメチルシクロペンタジエニルマグネシウムであることを特徴とする請求項1に記載の有機金属気相成長法。

【請求項3】ピスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物は、ピスイソプロピルシクロペンタジエニルマグネシウムであることを特徴とする請求項1に記載の有機金属気相成長法。

【請求項4】 I I - V I 族化合物半導体層の成長温度は、400万至600° Cであることを特徴とする請求項1万至請求項3のいずれか1項に記載の有機金属気相成長法。

【請求項5】 I I - V I 族化合物半導体層を形成するために用いられる I I 族元素を含む原料ガスに対する V I 族元素を含む原料ガスの供給量比が、2 乃至50であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の有機金属気相成長法。

【請求項6】ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物を蒸発させるために、該有機金属化合物を融点以上沸点以下に保持することを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の有機金属気相成長法。

【請求項7】 I I - V I 族化合物半導体層はZ n M g S S e から成ることを特徴とする請求項1乃至請求項6の 30 いずれか1項に記載の有機金属気相成長法。

【請求項8】 II-VI族化合物半導体層には、 $Zn_{1-1}Mg_1SSe$ (但し、 $X\neq Y$)とのヘテロ界面が形成されていることを特徴とする請求項7に記載の有機金属気相成長法。

【請求項9】2種類のII族元素及び2種類のVI族元素から成る四元混晶系化合物半導体層を形成する有機金属気相成長法であって、

II族元素を含む2種類の原料ガスのガス流量を一定に保持した状態で、VI族元素を含む2種類の原料ガスの40内の一方のガス流量を変化させることによって、化合物半導体層中のII族元素の組成割合を変化させることを特徴とする有機金属気相成長法。

【請求項10】2種類のII族元素及び2種類のVI族元素から成る四元混晶系化合物半導体層を形成する有機 金属気相成長法であって、

VI族元素を含む2種類の原料ガスのガス流量を一定に 保持した状態で、II族元素を含む2種類の原料ガスの 内の一方のガス流量を変化させることによって、化合物 半導体層中のVI族元素の組成割合を変化させることを 50 特徴とする有機金属気相成長法。

【請求項11】 I I 族元素を含む2種類の原料ガスの内の一方の原料ガスは、330° Kにおける蒸気圧が1.3×10Pa乃至1.3×10²Paであるビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物を含む原料ガスであることを特徴とする請求項9又は請求項10に記載の有機金属気相成長法。

2

【請求項12】ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物は、ビスメチルシクロペンタジエニルマグネシウムであることを特徴とする請求項11に記載の有機金属気相成長法。

【請求項13】ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物は、ビスイソプロピルシクロペンタジエニルマグネシウムであることを特徴とする請求項11に記載の有機金属気相成長法。

【請求項14】2種類のII族元素はZn及びMgから成り、2種類のVI族元素はS及びSeから成ることを特徴とする請求項11乃至請求項13のいずれか1項に記載の有機金属気相成長法。

20 【請求項15】請求項1乃至請求項14に記載の有機金 属気相成長法を用いることを特徴とする発光素子作製方 法。

【請求項16】発光素子を構成する化合物半導体層に、 ダブルヘテロ構造、グレーティッド構造、若しくはSC H構造を形成することを特徴とする請求項15に記載の 発光素子作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、II-VI族化合物半導体層を形成するための有機金属気相成長法(MOCVD法)、及びかかるMOCVD法を用いた半導体レーザやLED等の発光素子の作製方法に関する。

[0002]

【従来の技術】次世代の短波長半導体レーザ用の結晶材料として、II-VI族化合物半導体、特に基本的な材料と見なされているZnMgSSe化合物半導体の研究が進められている。ZnMgSSe化合物半導体は、大きなエネルギーバンドギャップを有しそしてZnSSeよりも小さな屈折率を有しているので、例えば、青色半導体レーザのクラッド層を構成する材料として適している。

【0003】II-VI族化合物半導体層は、現状では、GaAsから成る基板上に分子線エピタキシー法MBE (Molecular Beam Epitaxy) 法にてII-VI族化合物半導体層を形成することによって作製されている。MBE法においては、各種原料を分子線源(例えば、クヌードセンセル)に収納し、分子線源を加熱することによって得られた分子線を基板に照射することで、基板表面に化合物半導体層を形成する。

【0004】ところが、ZnMgSSe化合物半導体層

を形成するための原料の一種であるSをMBE法において蒸発させる場合、SやSeを収納した分子線源の加熱温度は約200°C以下と低く、分子線源の温度制御が不安定になり易い。そのため、基板表面に形成された化合物半導体層の組成制御が困難となる。特に、半導体レーザを作製する場合、化合物半導体層の組成が変動すると、半導体レーザの発光特性にばらつきが生じたり、設計通りに発光しなくなる。

【0005】化合物半導体層を形成する別の技術にMOCVD法がある。MOCVD法においては、化合物半導 10体層の組成をガス流量にて制御する。従って、化合物半導体層の組成制御を正確に行うことができる。また、MBE法では形成が極めて困難なグレーティッド構造を有する化合物半導体層を、化合物半導体層の組成のガス流量による制御によって、容易に形成することができる。【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のMOCVD法にて使用されているMg系有機金属材料は、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム [Mg (C $_5$ H $_5$) $_2$, 略称 (C $_p$) $_2$ M $_g$]である。この (C $_p$) $_2$ 2 Mgは、図8に示すように、蒸気圧が低い。通常の恒温槽内で使用できる温度範囲である370° K以下においては、(C $_p$) $_2$ M $_g$ 0の蒸気圧は $_1 \times _1$ 0 $_3$ 8トル (0.133Pa)以下である。従って、(C $_p$) $_2$ M $_g$ 1は、ドーパントとして使用するには十分であるが、結晶母材を成長させるには不適切である。一方、ジメチルジンク(DMZ $_n$)やジメチルセレン (DMS $_e$)は、数十~数百トルの蒸気圧を有し、容易にMOCVD法における結晶母材の原料ガスとして使用することができる。

【0007】 ZnSeから成る化合物半導体層をMOC VD法にて形成する技術は公知であるが、以上の理由から、現在までのところ、ZnMgSSeから成る化合物 半導体層をMOCVD法で基板上に結晶成長させる技術 は知られていない。

【0008】従って、本発明の第1の目的は、Mgを含む化合物半導体層を形成し得るMOCVD法を提供することにある。また、本発明の第2の目的は、化合物半導体層にグレーティッド構造を容易に形成することを可能にするMOCVD法を提供することにある。更に、本発明の目的は、半導体レーザやLED等の発光素子の新規 40の作製方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記の第1の目的を達成するための本発明の第1の態様に係るMOCVD法は、330° Kにおける蒸気圧が 1.3×10 Pa (0.1トル) 乃至 1.3×10 Pa (1.0トル) であるビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物を用いてII-VI族化合物半導体層を形成することを特徴とする。

【0010】本発明の第1の態様に係るMOCVD法に 50 できる。

おいては、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の 有機金属化合物は、ビスメチルシクロペンタジエニルマ グネシウム [Mg (CH₃ C₅ H₄)₂] あるいはビスイソ プロビルシクロペンタジエニルマグネシウム [Mg (i - C₃ H₇ C₅ H₄)₂] とすることができる。

【0011】また、II-VI族化合物半導体層の成長温度は、400乃至600°Cであることが望ましい。 更には、II-VI族化合物半導体層を形成するために用いられるII族元素を含む原料ガスに対するVI族元素を含む原料ガスの供給量比が、2乃至50であることが望ましい。また、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物を蒸発させるために、有機金属化合物を融点以上沸点以下に保持することが好ましい。

【0012】本発明の第1の態様に係るMOCVD法においては、II-VI族化合物半導体層はZnMgSSeから構成することができる。II-VI族化合物半導体層には、 $Zn_{1-1}Mg_1SSe$ と $Zn_{1-1}Mg_1SSe$ (但し、 $X \neq Y$)とのヘテロ界面を形成することができる。

【0013】上記の目的を達成するための本発明の第2の態様に係るMOCVD法は、2種類のII族元素及び2種類のVI族元素から成る四元混晶系化合物半導体層を形成するMOCVD法であって、II族元素を含む2種類の原料ガスのガス流量を一定に保持した状態で、VI族元素を含む2種類の原料ガスの内の一方のガス流量を変化させることによって、化合物半導体層中のII族元素の組成割合を変化させることを特徴とする。あるいは又、2種類のII族元素及び2種類のVI族元素から成る四元混晶系化合物半導体層を形成するMOCVD法であって、VI族元素を含む2種類の原料ガスのガス流量を一定に保持した状態で、II族元素を含む2種類の原料ガスの内の一方のガス流量を変化させることによって、化合物半導体層中のVI族元素の組成割合を変化させることを特徴とする。

【0014】本発明の第2の態様に係るMOCVD法においては、II族元素を含む2種類の原料ガスの内の一方の原料ガスは、330°Kにおける蒸気圧が1.3×10Pa乃至1.3×10Pa乃至1.3×10Paであるビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物を含む原料ガスとすることができる。この場合、ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合物は、ビスメチルシクロペンタジエニルマグネシウムあるいはビスイソプロピルシクロペンタジエニルマグネシウムである。2種類のII族元素はZn及びMgから成り、2種類のVI族元素はS及びSeから成ることが好ましい。

【0015】本発明の発光素子の作製方法は、以上に述べたMOCVD法を用いることを特徴とする。発光素子を構成する化合物半導体層に、ダブルヘテロ構造、グレーティッド構造、若しくはSCH構造を形成することができる

[0016]

【作用】本発明のMOCVD法においては、330°K における蒸気圧が1. 3×10Pa乃至1. 3×10² Paであるビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の 有機金属化合物を用いる。このような蒸気圧が高い有機 金属化合物を用いることによって、MOCVD法にてM gを含む化合物半導体層を結晶成長させることができ る。また、4つの原料ガスの内、1つの原料ガスの供給 量を制御することによって、四元混晶系化合物半導体層 の組成を容易に制御することができるので、組成制御性 10 に優れる。

[0017]

【実施例】以下、図面を参照して、実施例に基づき本発 明を説明する。

【0018】 (実施例1) 実施例1は、本発明の第1の 態様にかかるMOCVD法に関する。 実施例1では、ビ スシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合 物として、ピスメチルシクロペンタジエニルマグネシウ ム [Mg (CH₃ C₅ H₄)₂] [以下、 (Me Cp)₂ M gと略す場合もある]を用いる。また、II-VI族化 20 合物半導体層は、2nMgSSeから成る。実施例1に おいては、(MeCp)2Mgガスの供給量を変えたと きのZnMgSSe中のMg成分の変化を調べた。

【0019】 II-VI族化合物半導体層の成長温度を 480°C一定とし、H2キャリアガスを1.3リット ル/分一定とした。更に、ジメチルジンク(DMZ n)、ジメチルセレン(DMSe)及びジエチルサルフ ェイド(DES)の各原料ガス供給量を、以下の一定の 値とした。

DMZn : 1.1×10⁻⁵モル/分

DMSe : 3. 3×10⁻⁵モル/分

DES : 8.8×10⁻⁵モル/分

【0020】一方、(MeCp)2Mgガスの供給量 を、1.6×10⁻⁷モル/分まで種々変化させて、(1 00) GaAs基板上に、常圧MOCVD法にて2n 1-1 Mg1SSeから成る化合物半導体層を結晶成長させ て、数種の試料を作製した。尚、化合物半導体層の結晶 成長に先立ち、水素ガス雰囲気中で、600°C×10 分のサーマルエッチを基板に施した。

X)]と(MeCp)₂Mgガスの供給量との関係を 図1の直線「A」にて示す。Mg組成割合 [X/(1-X)]は、電子プループマイクロアナリシス法(EPM A法)から求めた。また、かかる各種試料のパンドギャ ップE₄と(MeCp)₂Mgガスの供給量との関係を図 1の直線「B」にて示す。パンドギャップE。は、77 [®] Kフォトルミネッセンス測定から求めた。

【0022】図1から明らかなように、(MeCp)2 Mgガスの供給量が増加するに従い、Mg組成割合 [X /(1-X)] は直線的に増加している。また、(Me 50 した。

Cp) 2 Mgガスの供給量が増加するに従い、パンドギ ャップE&も直線的に増加している。この結果から、M gが制御性良く化合物半導体結晶中に取り込まれ、四元 混晶系化合物半導体層が形成されていることが判る。ま た、再現性も良好であり、組成変動は3%以内に納まる ことが判った。

6

【0023】更に、77°Kにて測定した典型的なフォ トルミネッセンススペクトルを図2に示す。図2からも 明らかなように、バンド端発光以外に主な発光が認めら れないことが判る。特に、長波長側の深いレベルからの 発光が認められないことから、化合物半導体層は良好な 結晶性を有していることが判る。

【0024】また、図3にX線ロッキングカーブの結果 を示すが、半値幅として100秒程度の値が得られた。 この半値幅の小さいことからも、化合物半導体層は良好 な結晶性を有していることが判る。更に、化合物半導体 層の表面を顕微鏡観察したが、表面のモフォロジーは良 好であった。

【0025】これらの結果から、本発明のMOCVD法 にて形成したZnMgSSeから成る化合物半導体層中 の結晶欠陥は少なく、半導体レーザ等の発光素子の作製 に最適であることが判明した。

【0026】尚、試験の結果、II-VI族化合物半導 体層の成長温度が400°C未満では、原料ガスが熱分 解せず、基板上で結晶成長しない。また、化合物半導体 層の表面を顕微鏡観察したところ、成長温度が600° Cを越えると、化合物半導体層の表面のモフォロジーが 低下することが判った。

【0027】また、試験の結果、II-VI族化合物半 30 導体層を形成するために用いられる I I 族元素を含む原 料ガスに対するVI族元素を含む原料ガスの供給量比 は、2万至50の範囲にあることが望ましいことが判っ た。この供給量比がこの範囲から逸脱すると、77°K にて測定したフォトルミネッセンススペクトルに長波長 側の深いレベルからの発光が認められ、化合物半導体層 の結晶性が不良であった。また、化合物半導体層の表面 を顕微鏡観察した結果によれば、表面のモフォロジーは 不良であった。

【0028】 (実施例2) 実施例2は、本発明の第2の 【0021】かかる各種試料のMg組成割合[X/(1 40 態様にかかるMOCVD法に関する。実施例2では、ビ スシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金属化合 物として、(MeCp)2Mgを用いる。また、II-VI族化合物半導体層は、ZnMgSSeから成る。実 施例2においては、DMSeの供給量を変えて、ZnM gSSe中のZn/Mgの組成変化を調べた。

> 【0029】II-VI族化合物半導体層の成長温度を 480°C一定とし、H2キャリアガスを1.3リット ル/分一定とした。更に、DMZn、 (MeCp) 2M g及びDESの各原料ガス供給量を、以下の一定の値と

DMZn: 1.1×10⁻⁵モル/分 (MeCp) 2Mg: 1.2×10⁻⁷モル/分 DES : 8.8×10⁻⁵モル/分

【0030】一方、DMSeガスの供給量を1.6×1 0-5モル/分~3. 3×10-5モル/分まで種々変化さ せて、(100)GaAs基板上に常圧MOCVD法に てZn1-1Mg1SSeから成る化合物半導体層を結晶成 長させて、数種の試料を作製した。尚、化合物半導体層 の結晶成長に先立ち、水素ガス雰囲気中で、600°C ×10分のサーマルエッチを基板に施した。

【0031】かかる各種試料のMg組成 [X] とDES /DMSeの供給量割合との関係を図4に示す。Mg組 成[X]は、電子ブループマイクロアナリシス法(EP MA法)から求めた。図4から明らかなように、DES /DMSeの供給量割合が増加するに従い、Mg組成 [X] は直線的に増加している。この結果から、DES /DMSeの供給量割合を制御することによって、Mg 組成を制御できる。それ故、例えば、グレーティッド構 造を有する化合物半導体層を容易に形成することが可能*

> 原料ガス : DMZn

DES DMSe

ドーパント : C2 H5 I

キャリアガス: H2

結晶成長温度: 480°C

尚、II族元素を含む原料ガス [DMZn+(MeC p)₂Mg]に対するVI族元素を含む原料ガス[DE S+DMSe]の供給量比(VI/II比)は、11で ある。

【0034】尚、以下の各工程において、(MeCp) 2Mgを蒸発させるために、MOCVD装置における (MeCp)₂Mgを納めた恒温槽の温度を、(MeC p) 2 M g の融点 (30°C) 以上沸点 (56°C) 以※

> 原料ガス : DMZn

DES

DMSe

キャリアガス: H₂

結晶成長温度: 480°C

尚、II族元素を含む原料ガス [DMZn+ (MeC p) 2 Mg] に対するVI族元素を含む原料ガス [DE S+DMSe]の供給量比は、11である。

【0036】 [工程-320] その後、活性層12上

原料ガス : DMZn

(MeCp) 2Mg 1. 7×10⁻⁷モル/分

DMSe

ドーパント : t-BNH₂

DES

キャリアガス: H2

*である。

【0032】 (実施例3) 実施例3は、本発明の第1の 態様にかかるMOCVD法、及びかかるMOCVD法を 用いた半導体レーザから成る発光素子の作製方法に関す る。ビスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金 属化合物として(MeCp)2Mgを用いた。半導体レ ーザのクラッド層を構成するII-VI族化合物半導体 層はZnMgSSeから成る。また、発光素子を構成す る化合物半導体層には、ダブルヘテロ構造を形成する。 10 以下、実施例3のMOCVD法及び半導体レーザの作製

8

方法を説明する。 【0033】 [工程-300] 先ず、MOCVD装置内 に配置したn型(100)GaAs基板10の表面に、

チを施し、GaAs基板10の表面を清浄化した。次 に、GaAs基板10上に、厚さ1.5μmのn-Zn 0.9 Mg0.1 SSeから成る第1クラッド層11をMOC VD法にて形成した。形成条件を以下に例示する。

水素ガス雰囲気中で600°C×10分のサーマルエッ

1. 1×10⁻⁵モル/分

(MeCp) 2Mg 1. 7×10⁻⁷モル/分

8. 8×10⁻⁵モル/分

3. 3×10 - 5モル/分 1. 0×10⁻⁶モル/分

1. 3リットル/分

※下(例えば45°C)に保持した。この恒温槽内の液状 の (MeCp) 2 Mgを水素ガスでパブリングして、水 素ガスをキャリアガスとして (MeCp) 2 Mgガスを 30 MOCVD装置に搬送・供給する。

【0035】 [工程-310] 次に、第1クラッド層1 1上に、厚さ0. 07μmのZno.98 Mgo.02 SSeか ら成る活性層12をMOCVD法にて形成した。 形成条 件を以下に例示する。

1. 1×10⁻⁵モル/分

(MeCp) 2Mg 3. 0×10-8モル/分

8. 8×10⁻⁶モル/分

3. 3×10⁻⁵モル/分

1. 3リットル/分

に、厚さ1. 5μmのp-Zn_{0.90}Mg_{0.10}SSeから 成る第2クラッド層13をMOCVD法にて形成した。 形成条件を以下に例示する。

1. 1×10⁻⁵モル/分

8. 8×10 - 5モル/分

3. 3×10 ⁻⁵モル/分

1. 0×10⁻³モル/分

1. 3リットル/分

結晶成長温度: 480°C

尚、II族元素を含む原料ガス [DMZn+ (MeC p) 2 M g] に対する V I 族元素を含む原料ガス「DE S+DMSe] の供給量比は、11である。

【0037】こうして、第1クラッド層11と活性層1 2の間、及び活性層12と第2クラッド層13の間に は、Zn₁-xMgxSSeとZn₁-xMgxSSe(但し、*

> 原料ガス : DMZn

> > DMSe

下に例示する。 1. 1×10⁻⁵モル/分

6. 6×10⁻⁵モル/分

1. 3リットル/分

れる。

ドーパント : t-BNH₂ 1.0×10⁻³モル/分

キャリアガス: H2

結晶成長温度: 480°C

【0039】 [工程-340] 次いで、GaAs基板1 0の底面にAuGe/Ni/Auから成るn型電極15 を形成し、キャップ層14上にPd/Pt/Auから成 るp型電極16を形成し、400°C×1分のアニール 処理を行うことによって電極を完成させる。こうして、 図5に模式的な一部断面図を示すように、ダブルヘテロ 構造を有する半導体レーザから成る発光素子が作製され る。

【0040】実施例3においては、活性層12を2nM gSSe系化合物半導体層から構成したが、代わりに、 例えばZnCdSe、ZnSe、ZnSSe等の化合物 半導体から構成することもできる。

【0041】 (実施例4) 実施例4は、本発明の第1の 態様にかかるMOCVD法、及びかかるMOCVD法を 用いた半導体レーザから成る発光素子の作製方法に関す る。ピスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有機金 属化合物として (MeCp) 2 Mgを用いた。半導体レ※

> 原料ガス : DMZn

> > (MeCp) 2Mg 3. 0×10-8モル/分

DES DMSe

ドーパント : C2H5I キャリアガス: H2

結晶成長温度: 480°C

尚、II族元素を含む原料ガス [DMZn+ (MeC p) 2 Mg] に対するVI族元素を含む原料ガス [DE S+DMSe]の供給量比は、11である。

【0044】 [工程-420] 次に、第1光ガイド層2 40 結晶成長温度: 480°C 0上に、厚さ0. 01μmのZnCdSeから成る活性 層12をMOCVD法にて形成した。形成条件を以下に 例示する。

原料ガス : DMCd 1. 0×10⁻⁵モル/分

> 原料ガス : DMZn

(MeCp) 2Mg 3. 0×10⁻⁸モル/分

DES DMSe

ドーパント : t-BNH₂ キャリアガス: H2

る化合物半導体層には、SCH構造を形成する。以下、

実施例4のMOCVD法及び半導体レーザの作製方法を 説明する。

層はZnMgSSeから成る。また、発光素子を構成す

※一ザのクラッド層を構成するII-VI族化合物半導体

10

*X=0.10、Y=0.02) とのヘテロ界面が形成さ

【0038】 [工程-330] その後、第2クラッド層

13上に、厚さ0. 5μ mのp-ZnSeから成るキャ

ップ層14をMOCVD法にて形成した。形成条件を以

【0042】 [工程-400] 先ず、MOCVD装置内 に配置したn型(100)GaAs基板10の表面に、

20 水素ガス雰囲気中で600°C×10分のサーマルエッ チを施し、GaAs基板10の表面を清浄化した。次 に、GaAs基板10上に、厚さ1.5μmのn-Zn 0.90 Mg0.10 SSeから成る第1クラッド層11を、実 施例3の[工程-300]と同様の条件のMOCVD法 にて形成した。

【0043】 [工程-410] 次に、第1クラッド層1 1上に、厚さ0. 1μmのn-Zno.98 Mgo.02 SSe から成る第1光ガイド層20をMOCVD法にて形成し た。形成条件を以下に例示する。

1. 1×10⁻⁶モル/分

8. 8×10 - 5モル/分

3. 3×10⁻⁵モル/分

1. 0×10⁻⁶モル/分

1. 3リットル/分

1. 1×10⁻⁵モル/分 DMZn

1. 2×10⁻⁴モル/分 DMSe

キャリアガス: H2 1. 3リットル/分

【0045】 [工程-430] その後、活性層12上 に、厚さ0. 1μmのp-Zno.98 Mgo.02 SSeから 成る第2光ガイド層21をMOCVD法にて形成した。

形成条件を以下に例示する。

1. 1×10⁻⁵モル/分

8. 8×10 - 5モル/分 3. 3×10 ⁻⁵ モル/分

1. 0×10⁻³モル/分

1. 3リットル/分

—736—

結晶成長温度: 480°C

尚、II族元素を含む原料ガス [DMZn+ (MeC p) 2 Mg] に対するVI族元素を含む原料ガス「DE S+DMSe]の供給量比は、11である。

【0046】 [工程-440] 次いで、第2光ガイド層 21上に、厚さ1. 5μmのp-Zno.30 Mgo.10 SS eから成る第2クラッド層13を実施例3の [工程-3 20]と同様の条件のMOCVD法にて形成した。

【0047】こうして、第1クラッド層11と第1光ガ ド層13の間には、Zn₁₋₁Mg₁SSeとZn₁₋₁Mg₂ SSe(但し、X=0.10、Y=0.02) とのヘテ 口界面が形成される。

【0048】 [工程-450] その後、第2クラッド層 13上に、厚さ 0.5μ mのp-ZnSeから成るキャ ップ層14を、実施例3の[工程-330]と同様の条 件のMOCVD法にて形成した。

【0049】 [工程-460] 次いで、実施例3の [工 程-340] と同様の方法でGaAs基板10の底面に 6を形成する。こうして、図6に模式的な一部断面図を 示すように、SCH構造を有する半導体レーザから成る 発光素子が作製される。

【0050】実施例4においては、活性層12を2nC dSe系化合物半導体層から構成したが、代わりに、例 えば2nSeTe等の化合物半導体から構成することも できる。また、第1クラッド層20,第2クラッド層2 1を2nMgSSe系化合物半導体層から構成したが、 代わりに、例えばZnSe、ZnSSe等の化合物半導*

> 原料ガス : DMZn

DES

DMSe

モル/分 ドーパント : C₂ H₅ I

> キャリアガス: H2 結晶成長温度: 480°C

尚、DMSeは、上記のように、8分間に3.3×10 -5 モル/分から7. 0×10-5 モル/分まで供給量を連 続的に変化させた。これによって、Ζno.seMgo.o2S 40 0上に、厚さ0.01μmのZnCdSeから成る活性 SeからZno.99 Mgo.01 SSeへと組成が連続的に変 化して成る第1光ガイド層30が形成された。尚、DM Seの供給量を段階的に変化させてもよい。これによっ て、Zn及びMgの組成割合が段階的に変化して成る第 1光ガイド層30を形成することができる。また、DM Seの供給量を変化させる代わりに、DESの供給量を

> 原料ガス : DMZn

> > (MeCp) 2Mg 3. 0×10-8モル/分

DES

DMSe

8. 8×10 - 5モル/分

1. 1×10-6モル/分

7. $0 \times 10^{-5} \sim 3$. 3×10^{-5}

*体から構成することもできる。

【0051】 (実施例5) 実施例5は、本発明の第1及 び第2の態様にかかるMOCVD法、並びにかかるMO CVD法を用いた半導体レーザから成る発光素子の作製 方法に関する。ビスシクロペンタジエニルマグネシウム 系の有機金属化合物として(MeCp)2Mgを用い た。半導体レーザのクラッド層を構成するII-VI族 化合物半導体層はZnMgSSeから成る。また、発光 イド層20の間、及び第2光ガイド層21と第2クラッ 10 素子における光ガイド層を構成する化合物半導体層に は、グレーティッド構造を形成する。第1及び第2クラ ッド層を本発明の第1の態様にかかるMOCVD法にて 形成し、グレーティッド構造を有する第1及び第2光ガ イド層を本発明の第2の態様にかかるMOCVD法にて 形成する。以下、実施例5のMOCVD法及び半導体レ ーザの作製方法を説明する。

12

【0052】 [工程-500] 先ず、MOCVD装置内 に配置したn型(100) GaAs基板10の表面に、 水素ガス雰囲気中で600°C×10分のサーマルエッ n型電極15を形成し、キャップ層14上にp型電極1 20 チを施し、GaAs基板10の表面を清浄化した。次 に、GaAs基板10上に、厚さ1.5μmのn-Zn 0.90 Mg0.10 SSeから成る第1クラッド層11を、実 施例3の[工程-300]と同様の条件のMOCVD法 にて形成した。

> 【0053】 [工程-510] 次に、第1クラッド層1 1上に、厚さ0. 1 µmの第1光ガイド層30を本発明 の第2の態様に係るMOCVD法にて形成した。形成条 件を以下に例示する。

1. 1×10-5モル/分

(MeCp) 2Mg 3. 0×10-8モル/分

8. 8×10 -5モル/分

3. $3 \times 10^{-5} \sim 7$. 0×10^{-5}

1. 0×10⁻⁶モル/分

1. 3リットル/分

連続的若しくは段階的に変化させてもよい。

【0054】 [工程-520] 次に、第1光ガイド層3 層12を、実施例4の[工程-420]と同様の条件の MOCVD法にて形成した。

【0055】 [工程-530] その後、活性層12上 に、厚さ 0. 1 μ m の 第 2 光ガイド 層 3 1 を 本 発明 の 第 2の態様に係るMOCVD法にて形成した。形成条件を 以下に例示する。

13 モル/分

ドーパント: t-BNH₂

キャリアガス: H2

結晶成長温度: 480°C

尚、DMSeは、上記のように、8分間に7.0×10 -5 モル/分から3.3×10-5 モル/分まで供給量を連 続的に変化させた。これによって、Zno.99 Mgo.01 S SeからZno.98 Mgo.02 SSeへと組成が連続的に変 化して成る第2光ガイド層31が形成された。尚、DM て、Zn及びMgの組成割合が段階的に変化して成る第 2光ガイド層31を形成することができる。また、DM Seの供給量を変化させる代わりに、DESの供給量を 連続的若しくは段階的に変化させてもよい。

【0056】 [工程-540] 次いで、第2光ガイド層 31上に、厚さ1. 5μmのp-Zn_{0.90}Mg_{0.10}SS eから成る第2クラッド層13を、実施例3の[工程-320]と同様の条件のMOCVD法にて形成した。

【0057】こうして、第1光ガイド層30及び第2光 ガイド層31には、Zni-iMgiSSeからZni-iM 20 grSSe (但し、X=0.10、Y=0.02) へと 変化する(あるいはその逆に変化する)ヘテロ界面(グ レーティッド構造)が形成される。

【0058】 [工程-550] その後、第2クラッド層 13上に、厚さ0. 5μ mのp-ZnSeから成るキャ ップ層14を、実施例3の[工程-330]と同様の条 件のMOCVD法にて形成した。

【0059】 [工程-560] 次いで、GaAs基板1 0の底面にAuGe/Ni/Auから成るn型電極15 を形成し、キャップ層14上にPd/Pt/Auから成 30 るp型電極16を形成し、400°C×1分のアニール 処理を行うことによって電極を完成させる。こうして、 図7に模式的な一部断面図を示すように、グレーティッ ド構造を有するGRIN-SCH構造を有する半導体レ ーザから成る発光素子が作製される。

【0060】実施例5においては、活性層12を2nC dSe系化合物半導体層から構成したが、代わりに、例 えばZnSeTe等の化合物半導体から構成することも できる。

【0061】実施例5においては、また、グレーティッ 40 ド構造を有する第1クラッド層30,第2クラッド層3 1を、本発明の第2の態様に係るMOCVD法にて形成 したが、代わりに本発明の第1の態様に係るMOCVD 法にて形成することもできる。この場合には、原料ガス 供給量を連続的にあるいは段階的に変化させればよい。 第1クラッド層30, 第2クラッド層31を、本発明の MOCVD法に基づかずに、例えばZnSe、ZnSS e等の化合物半導体から構成することもできる。

【0062】以上、好ましい実施例に基づき本発明を説

1. 0×10⁻³モル/分

1. 3リットル/分

はない。各実施例にて説明した条件や組成は例示であ り、適宜変更することができる。ビスシクロペンタジエ ニルマグネシウム系の有機金属化合物として、ピスメチ ルシクロペンタジエニルマグネシウムを用いたが、その 代わりに、ピスイソプロピルシクロペンタジエニルマグ Seの供給量を段階的に変化させてもよい。これによっ 10 ネシウムを用いて同様の条件で化合物半導体層を形成す ることができる。

14

【0063】実施例においては、Mg含有混晶系化合物 半導体層としてZnMgSSe系化合物半導体層を例に とり説明したが、その他、ZnMgTe等のMg含有混 晶系化合物半導体層の結晶成長に対して本発明を適用す ることができる。

【0064】n型ドーパントとしてC2H5Iを使用した が、その代わりにCHゥⅠ、n-CィHゥⅠ、tert-C4 He I を使用することができる。また、p型ドーパン トとしてt-BNH2 (tert-C4H9NH2)を使用 したが、その代わりにNH₃、CH₃N₃、C₂H₅N₃、 (CH₃) 2NNH2を使用することができる。また、n -GaAs基板の代わりにp-GaAs基板を用いるこ ともできる。この場合、各化合物半導体層のn型、p型 を実施例にて説明した状態と逆にすればよい。

【0065】実施例3~実施例5においては、発光素子 として半導体レーザを例にとり説明したが、本発明の発 光素子にはLEDも包含される。例えば実施例3と基本 的には同様の構造を有するLEDを本発明のMOCVD 法にて作製することができる。更には、RGB(光の三 原色)を発光するLEDや半導体レーザをモノリシック に組み立て、電子銃から射出された電子ビームをこれら のLEDや半導体レーザに衝突させて、これらのLED や半導体レーザからRGBを発光させる形式の発光素子 も本発明の発光素子に包含され、かかる発光素子を本発 明のMOCVD法にて作製することもできる。

【0066】実施例5においては、専ら、DMSe若し くはDESの供給量を連続的あるいは段階的に変化させ ることによって2n/Mgの組成を連続的あるいは段階 的に変化させる態様を説明したが、その代わりにDMZ n若しくは (MeCp) 2Mgの供給量を連続的あるい は段階的に変化させて、S/Se組成割合を連続的ある いは段階的に変化させることもできる。また、多重量子 井戸構造、変形多重量子井戸構造を有する化合物半導体 層の形成に、本発明のMOCVD法を適用することもで きる。

[0067]

【発明の効果】本発明により、正確に組成が制御された Mgが含まれる化合物半導体層をMOCVD法にて形成 明したが、本発明はこれらの実施例に限定されるもので 50 することができる。また、併せて、原料ガスの内の一種

類の原料ガス供給量を制御することによって、四元混晶 系化合物半導体層の組成を容易に制御することができ、 化合物半導体層にグレーティッド構造を容易に形成する ことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (MeCp) 2 Mgガスの供給量と、Mg組成 割合 [X/(1-X)] 並びにパンドギャップEgとの 関係を示す図である。

【図2】実施例1にて得られた試料の77° Kにて測定 した典型的なフォトルミネッセンススペクトルを示す図 10 11,13 クラッド層 である。

【図3】 X線ロッキングカープの結果を示す図である。

【図4】Mg組成 [X] とDES/DMSeの供給量割 合との関係を示す図である。

【図5】実施例3の半導体レーザの模式的な一部断面図

である。

【図6】実施例4の半導体レーザの模式的な一部断面図 である。

16

【図7】実施例5の半導体レーザの模式的な一部断面図 である。

【図8】ピスシクロペンタジエニルマグネシウム系の有 機金属化合物の蒸気圧を示すグラフである。

【符号の説明】

10 GaAs基板

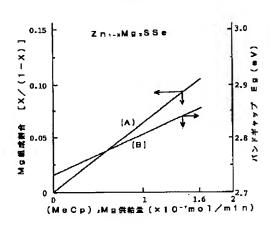
12 活性層

14 キャップ層

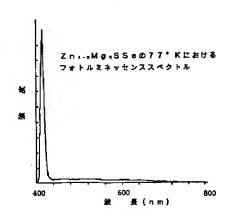
15, 16 電極

20, 21, 30, 31 光ガイド層

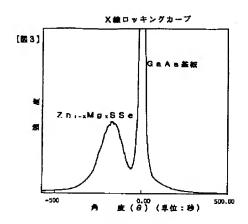
【図1】



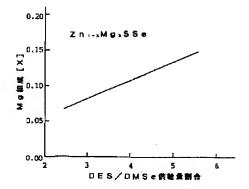
[図2]

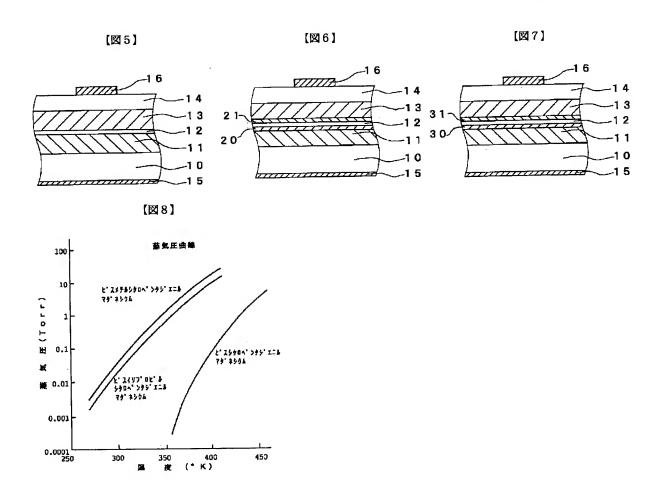


【図3】



【図4】





【手続補正書】

【提出日】平成6年11月15日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正内容】

【0019】 I I-V I 族化合物半導体層の成長温度を480° C一定とし、H2キャリアガスを1.3リット

ル/分一定とした。更に、ジメチルジンク(DMZ n)、ジメチルセレン(DMSe)及びジエチルサルフ \underline{r} イド(DES)の各原料ガス供給量を、以下の一定の値とした。

DMZn : 1. 1×10⁻⁵モル/分 DMSe : 3. 3×10⁻⁵モル/分

DES : 8.8×10⁻⁵モル/分